

보도시점 2024. 1. 23.(화) 11:00
< 1.24.(수) 조간 >

배포 2024. 1. 23.(화)

첨단산업 등 국내복귀 투자 유인책(인센티브)을 확대한다

- 국가·첨단전략기술, 공급망핵심 분야 등 유턴 촉진을 위해 1,000억 원 투입

산업통상자원부(장관 안덕근) 박덕열 투자정책관은 1.23.(화) 반도체 부품 제조 국내복귀(이하 “유턴”) 기업인 (주)심텍 청주공장을 방문하여 생산시설과 투자 예정공간 등을 둘러보며 현장의 애로를 청취하고 정부의 지원제도 등을 설명하였다.

(주)심텍('23.5.25. 유턴기업 선정)은 반도체 및 모바일용 인쇄회로기판(PCB)*를 주로 생산하는 첨단기술 보유업체로 기존 청주공장의 여유 공간에 생산설비 확충을 지속할 계획이다.

* PCB(Printed Circuit Board) : 회로가 그려진 얇은 판으로 반도체 등 전기부품을 탑재하고 전기적으로 연결

정부는 첨단전략산업 및 공급망핵심 분야 등 고부가가치 기업의 유턴 투자를 촉진하기 위해 '24년 투자보조금 예산을 대폭 확대('23년 570억 원 → '24년 1,000억 원)하였으며, 법인세 감면기간도 10년으로 연장(기존: 7년)하는 등 유턴기업에 대한 지원을 강화하여 시행한다.

특히, 반도체·디스플레이·이차전지·백신 등 국가전략*·첨단전략기술** 보유 유턴기업이 비수도권 투자 시에는 45%(기존: 21%), 수도권 투자 시에는 26%(기존: 미지원)의 기본보조율을 적용하여 투자보조금을 지원한다.

* 「조세특례제한법」 별표7의2에 따른 반도체, 이차전지, 백신, 디스플레이 관련 기술

** 「국가첨단전략산업법」에 따라 지정된 반도체, 이차전지, 디스플레이, 바이오 관련 기술

아울러, 비수도권에 투자하는 첨단업종*, 국가전략·첨단전략기술 분야에 대해서도 최대 75%의 국비분담율을 적용(기존: 소부장핵심전략기술**만 적용)하여, 해당 분야의 투자유치를 촉진함과 동시에 지방자치단체의 재정부담을 완화할 계획이다.

* 「산업발전법상」상 첨단업종, 「조세특례제한법」상 신성장동력기술 수반 업종

** 「소재부품장비산업법」상 산업통상자원부장관의 확인을 받은 기술




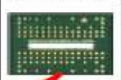








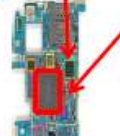

박덕열 투자정책관은 “첨단산업 등의 유턴투자는 투자·고용 등 지역 경제 활성화와 수출 동력 확보를 위해서도 매우 중요하다” 라고 강조하면서, “앞으로도 이들 기업의 국내복귀를 적극적으로 지원할 예정이다” 라고 밝혔다.

담당 부서	투자정책관 해외투자과	책임자	과 장	김현진 (044-203-4090)
		담당자	주무관	이영현 (044-203-4096)

참고

(주)심텍 개요

- 대표자 : 최시돈, 김영구
- 본사 소재 : 충북 청주시 흥덕구 산단로 73
- 업종 : 인쇄회로기판 제조업 (중견기업)
- 종업원 : 2,967명('22)
- 매출액 : 1조 6,974억원('22)
- 수출 : 10억불 수출의 탑 수상('22) 등
- 주요 생 산 품 목

구분	Module PCB	Substrate PCB
기능	Memory 반도체칩을 하나의 PCB 위에 여러개를 고밀도 실장하여 PC나 Server의 Memory 용량을 확장시키는 기능	반도체칩이나 전자부품이 기능을 수행하기 위해 PCB기판에 탑재 및 전기적으로 연결되어야하며 반도체칩과 메인PCB간 전기적 신호의 연결 통로 기능
제품	<div>SSD용 메모리모듈</div>  <div>PC용 메모리모듈</div>  <div>Server용 모듈</div>  <div>BOC (for DDR4~5)</div>  <div>GDDR6 Substrate</div>  <div>MCP (for Mobile DRAM, NAND)</div>  <div>FC-CSP (for AP etc)</div>  <div>SiP (for Wearable)</div> 	
적용	 SSD  PC/Notebook  Server  Gaming Console Graphic Card  Smart Mobiles  Wearable	
용어	<ul style="list-style-type: none"> ○ BOC(Board on Chip) : 리미티드기판 위에 메모리칩 본딩면이 부착된 형태로 수직적층 고속화 및 대용량화 용이 ○ GDDR6(Graphics DDR6) : 그래픽카드, 게임콘솔, 고성능 연산에 사용하기 위한 차세대 D램 ○ MCP(Multi-Chip Package) : 기판위에 얇은 칩을 여러개 수직적층하여 메모리 성능 증가 및 면적효율 극대화 ○ FC-CSP(Flip-Chip Chip Size Package) : 칩 상부에 연결을 위한 범프 형성 후 칩 자체를 뒤집어서 패키지 기판의 단자와 연결하는 방식으로 접속 지점을 다수 형성할 수 있어 고성능 반도체칩에 사용 ○ SiP(System in Package) : 하나의 패키지 위에 시스템과 연동되어 서로 다른 기능을 수행하는 능동소자들을 패키징하는 것으로 초소형 시스템반도체 핵심기능을 최적화하여 제공 	